

THÔNG BÁO

V/v gửi bài tham dự Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn - ISTP30

Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn (International Symposium on Transport Phenomena - ISTP30), sẽ được Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 năm 2019 tại Hạ Long.

Công trình khoa học báo cáo tại Hội nghị sẽ được: In trong Proceedings (có chỉ số ISSN/ISBN), công bố trên tạp chí Physics Of Fluids (tạp chí xếp hạng Q2) sau khi qua vòng phản biện bổ sung, hoặc công bố (có tính phí) trên tạp chí Scopus, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (tạp chí xếp hạng Q4).

Các mốc thời gian, thể lệ và các thông tin khác của Hội nghị tham khảo nội dung file đính kèm; Nhà trường thông báo rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học quan tâm gửi bài tham dự Hội nghị./.

Nơi nhận:

- Giám hiệu;
- Đưa lên egov, website;
- Lưu: VT, KHCN.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



PGS.TS. Phạm Văn Bồng

Số: 367 /ĐHBK-QLNC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019



Handwritten signature and initials: 'yng' and '92'

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn (The 30th International Symposium on Transport Phenomena - ISTP30) Hạ Long, 1-3 tháng 11/2019

Kính gửi: *Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội*

Theo quyết định số 1424/BGDĐT-HTQT, ngày 05/04/2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội nghị quốc tế ISTP30 sẽ được tổ chức tại Hạ Long, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 năm 2019. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được giao trách nhiệm tổ chức Hội nghị này.

Hội nghị được bảo trợ bởi Trung tâm Kỹ thuật nhiệt chất lỏng Thái Bình Dương (PCTFE), Hiệp hội Truyền nhiệt Nhật Bản (HTSJ) và Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Nhật Bản (JSME). Hội nghị có sự tham gia và trình bày của các keynotes là các nhà khoa học quốc tế uy tín như GS. A. Jeffrey Giacomini (Queen's University, Canada, Tổng biên tập tạp chí Physics of Fluids), GS. Phan Thien Nhan (National University of Singapore), GS. Greta Tryggvason (Johns Hopkins University) và GS. Naoki Shikazono (University of Tokyo).

Ngôn ngữ sử dụng của Hội nghị: Tiếng Anh.

Các hình thức tham gia Hội nghị: Tác giả đăng ký và gửi bài trực tiếp trên website Hội nghị (www.istp30.com).

Thời hạn nộp tóm tắt (gia hạn đến): 31/5/2019.

Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 01/7/2019.

Phí tham gia Hội nghị: 450 USD cho học giả quốc tế, 300 USD cho sinh viên quốc tế. Đối với học giả và Sinh viên Việt nam, phí tham dự là 2.300.000 VNĐ (bao gồm Tea-break và ăn trưa tại các buổi báo cáo) và 3.000.000 VNĐ (bao gồm Tea-break, ăn trưa tại các buổi báo cáo và Gala dinner).

Công trình khoa học được báo cáo tại Hội nghị sẽ được: In trong Proceedings (có chỉ số ISSN/ISBN), công bố trên tạp chí Physics Of Fluids (tạp chí xếp hạng Q2) sau khi qua vòng phản biện bổ sung, hoặc công bố (có tính phí) trên tạp chí Scopus, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (tạp chí xếp hạng Q4).

Để Hội nghị diễn ra thành công, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội kính đề nghị Quý Trường/Viện thông báo rộng rãi thông tin về Hội nghị tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các đối tác của đơn vị viết bài tham gia.

Thông báo này được gửi kèm Call for Paper của Hội nghị.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Trường/Viện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCTH, QLNC.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. *Dinh Văn Phong*

Call for Papers

The 30th International Symposium on Transport Phenomena
November 1-3, 2019, Vinpearl Resort, Halong, Vietnam

Promoting the success of ISTP symposium series, the 30th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP30) will be held in Vinpearl, Halong Bay, Vietnam on 1-3rd November 2019. ISTP30 is organized by Hanoi University of Science and Technology (HUST) and with the sponsorship of Pacific Center of Thermal-Fluids Engineering, The Heat Transfer Society of Japan (HTSJ) and The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME). ISTP30 aims to bring together academic scientists, researchers, and manufacturers to exchange up-to-date research and technological information on any aspect of transport phenomena and thermal- fluids engineering.

Halong Bay is a UNESCO World Heritage Site, a New World Wonder of Nature, one of the top tourist destinations in Southeast Asia. The symposium venue, Vinpearl, is a small and beautiful island in Halong Bay, a perfect place for participants to deepen mutual relationship for future collaborations across the countries and regions in session rooms, at the coffee breaks and symposium events, and also at the various relaxing and exciting off -the-venue locations in Halong Bay.

Scope

- Bioengineering and Bio-thermal Fluid Dynamics
- Biofuels sustainability
- Boiling and Multi-Phase Flow
- Combustion and Reacting Flows
- Electronics Packaging and Thermal Management
- Experimental/Computational Fluid Dynamics
- Fuel Cells and Battery Technology
- Heat and Mass Transfer
- Heat Exchangers
- Hybrid vehicles sustainability
- Industrial Aerodynamics
- Manufacturing and Materials Processing
- MEMS
- Micro- and Nano-Scale Transport
- Noise and Vibration in Fluid
- Renewable energy technologies
- Sustainable & Renewable Energy
- Thermal-Fluids Machinery
- Thermal Hydraulics of Energy Reactors

Transport in Porous Media
Transport phenomena in solid mechanics and fluid-structure interaction
Turbulence and Flow Instabilities
Visualization/Imaging Techniques

Plenary Speakers

Professor Phan Thien Nhan, National University of Singapore Singapore
Professor Gretar Tryggvason, Johns Hopkins University
Professor Naoki Shikazono, University of Tokyo

Honored guest

Professor A. Jeffrey Giacomin, PhD, PE, PEng, FSOR, President, Canadian Society of Rheology, Editor-in-Chief, Physics of Fluids

Submission

All abstracts and papers must follow ISTP30 template to be submitted on the symposium website: www.istp30.com (<http://www.istp30.com/>)

All the papers will be peer-reviewed. The selected best papers will be extended analysis and results will be recommended to the special issues of Physics of Fluids Journal. Papers accepted and presented at ISTP30 have an option to publish on the Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (additional publication fee will be charged).

Registration fee

Regular(*)	Early-bird	USD 400
	Late	USD 450
Student	Early-bird	USD 250
	Late	USD 300

(*) Encouraging registration fee applied for domestic participants

Important Dates

May 31, 2019: Abstract submission deadline (extended)
June 15, 2019: Abstract acceptance notice (extended)
July 10, 2019: Draft paper submission deadline (extended)
July 25, 2019: Paper acceptance notice
August 15, 2019: Final paper submission deadline

Symposium Chair

Le Anh Tuan, Hanoi University of Science and Technology

Symposium Co-Chair

November 1-3, 2019, Vinpearl Resort , Halong, Vietnam

Kazuyoshi Fushinobu, Tokyo Institute of Technology

Secretariat

Pham Van Sang, Hanoi University of Science and Technology

Honorary Committee:

Le Anh Tuan, Hanoi University of Science and Technology

Ishizuka, M., Toyama Prefectural University

Ay, H., National Kaohsiung University of Applied Sciences

Brynjolfsson, S., University of Iceland

Cervantes de Gortari, J., National Univ. of Mexico

Chan, S. H., Yuan Ze University

Charoenphonphanich, C., KMITL

De Vahl Davis, G., Univ. of New South Wales

Dincer, I., University of Ontario Institute of Technology

Djilali, N., University of Victoria

Dost, S., University of Victoria

Fushinobu, K., Tokyo Institute of Technology

Hanamura, K., Tokyo Institute of Technology

Iguchi, M., Hokkaido University

Jezek, J., Czech Technical University in Prague

Lee, J. S., Seoul National University

Lee, S. Y., KAIST

Mallinson, G., University of Auckland

Mochizuki, S., Tokyo University of A&T

Rajapaksha, L., University of Peradenya

Raupenstrauch, H., Montanuniversitaet Leoben

Spitas, C., Delft University of Technology

Suzuki, K., Tokyo University of Science at Yamaguchi

Takeishi, K., Osaka Univesity

Tomimura, T., Kumamoto University

Wang, B. X., Tsinghua University

Winoto, S. H., National University of Singapore

Yanuar, University of Indonesia

Zuna, P., Czech Technical University in Prague

Executive Committee:

Le Anh Tuan, Hanoi University of Science and Technology

Kazuyoshi Fushinobu, Tokyo Institute of Technology

Pham Van Sang, Hanoi University of Science and Technology

Dinh Cong Truong, Hanoi University of Science and Technology

Hoang Thi Kim Dung, Hanoi University of Science and Technology

Pham Thi Thanh Huong, Hanoi University of Science and Technology

Ngo Ich Long, Hanoi University of Science and Technology

International Scientific Committee:

Agonafer, Dereje, University of Texas
Asano, Hitoshi, Kobe University
Bui Van Ga, Danang University
Dinh Cong Truong, Hanoi University of Science and Technology
Doan, Hong Duc, Vietnam National University at Hanoi
Duong Ngoc Hai, Vietnam Academy of Science and Technology
Duong Ngoc Khanh, Hanoi University of Science and Technology
Fukue, T., Kanazawa Institute of Technology
Fushinobu, K., Tokyo Institute of Technology
Hasmady, S., Tenaga National University
Hatakeyama, T., Toyama Prefectural University
Ho Xuan Thinh, Vietnamese-German University
Hoang Anh Tuan, Hochiminh City University of Transport
Hoang Thi Kim Dung, Hanoi University of Science and Technology
Ichimiya, Koichi, University of Yamanashi
Iwai, Hiroshi, Kyoto University
Joshi, Y., Georgia Tech
Kedzierski, M., NIST
Khong Vu Quang, Hanoi University of Science and Technology
Kibushi, Risako, Tokyo University of Science at Yamaguchi
Kikura, Hiroshige, Tokyo Institute of Technology
Kim, Sung Jin, KAIST
Kim, M.S., Seoul National University
Kobayashi, Kenichi, Meiji University
Kohno, Masamichi, Kyushu University
Komiya, A., Tohoku University
Kuzma-Kichta, Y. A. Moscow Power Eng. Institute
Le Anh Tuan, Hanoi University of Science and Technology
Le Duc Dung, Hanoi University of Science and Technology
Maruyama, S. National Institute of Technology, Hachinohe College
Matsumoto, Koji, Chuo University
Nakamura, Hajime, National Defense Academy
Nakamura, Yuji, Toyohashi University of Technology
Naylor, D., Ryerson University
Ngo Ich Long, Hanoi University of Science and Technology
Nguyen Minh Tuan, Hanoi University of Science and Technology
Nguyen Phu Khanh, Hanoi University of Science and Technology
Nguyen The Mich, Hanoi University of Science and Technology
Nishi, Koji, Ashikaga University
Ohara, T., Tohoku University
Okajima, Junnosuke, Tohoku University
Pham Hong Phuc, Hanoi University of Science and Technology
Pham Thi Thanh Huong, Hanoi University of Science and Technology
Pham Van Sang, Hanoi University of Science and Technology

Saito, Takushi Tokyo Institute of Technology
Saitoh, Hironori, Sojo University
Strunin, D., University of Southern Queensland
Takata, Y., Kyushu University
Takeda, Tetsuaki, University of Yamanashi
Tanahashi, Mamoru, Tokyo Institute of Technology
Tomimura, T. Kumamoto University
Tong, Albert Y., University of Texas at Arlington
Torii, S., Kumamoto University
Tran Khanh Duong, Hanoi University of Science and Technology
Tran Thanh Hai Tung, Danang University
Tran Van Nam, Danang University
Tran Viet Dung, Hanoi University of Science and Technology
Truong Viet Anh, Hanoi University of Science and Technology
Vafai, K., UC Riverside
Vu Dinh Quy, Hanoi University of Science and Technology
Vu Van Truong, Phenikaa University
Wang, Q., Xi'an Jiaotong University
Yazawa, Kazuaki, Purdue University
Yeh, L-T, Huawei Technologies
Yokono, Yasuyuki, The University of Tokyo
Yoshida, Atsumasa, Osaka Prefecture University
Yuki, K., Tokyo University of Science at Yamaguchi

Contact

Dr. Pham Van Sang

(Email: sang.phamvan@hust.edu.vn, Mobile: 0966 633 683)

Assoc. Dr. Hoang Thi Kim Dung

(Email: dung.hoangthikim@hust.edu.vn, Mobile: 0949 737 767)

Dr. Dinh Cong Truong

(Email: truong.dinhcong@hust.edu.vn, Mobile: 093 463 8035)

School of Transportation Engineering

Hanoi University of Science and Technology

Room 102 - C6 Building - 01 Dai Co Viet Rd. - Hai Ba Trung Dist. - Hanoi